

证券代码：688711
转债代码：118040

证券简称：宏微科技
债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
(2025年5月5日至2025年5月28日)

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场调研 ☒电话会议 ☒其他
参会单位名单	1、5月5日 电话会 中欧基金 2、5月8日 策略会等其他形式 东吴证券 3、5月14日 电话会 百年保险、融通基金、博时基金、中信证券 4、5月15日 现场调研 中信证券 5、5月20日 现场调研 华安证券、深圳前海阶石资本管理有限公司 6、5月23日 现场调研 广东时代传媒集团有限公司、德邦控股集团有限公司、上海贵源投资有限公司、上海证券报、观察者网、东方财富证券股份有限公司、上海湘晨投资管理有限公司、上海晨步企业管理有限公司、杨文杰 7、5月28日 策略会等其他形式 富国基金 (以上排名不分先后)
时间	2025年5月5日至2025年5月28日

地点	公司、线上、上海
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 马君
投资者关系活动主要内容介绍	1、公司 2025 年第一季度工控业务为什么快速增长？ 2025 年第一季度，公司工控领域收入同比增长 36%，营收占比提升至 49%，一方面受益于传统业务订单需求拉动，尤其是工程机械、变频器等下游行业需求持续回暖，头部客户订单集中释放；其次，公司积极拓展新兴应用场景，数据中心服务器电源及 UPS 形成批量订单，带动工控产品结构向高附加值方向升级。 本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。 2、2025 年是否具备持续盈利基础？ 公司坚持长期投入，通过优化产品结构、强化客户组合等手段提升韧性。2025 年，公司业绩回暖明显，Q1 实现营收 2.97 亿元，同比增长 20.70%，归母净利润 108.37 万元，实现扭亏为盈。公司盈利修复基于结构改善与效率提升，为未来稳健增长打下基础。 本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。 3、公司 SiC 芯片和模块进展如何？ 近年来，公司持续加大对核心技术的研发投入，第三代半导体是公司今年主要聚焦的方向。2025 年第一季度，公司碳化硅产品加速出货，产品收入占比超 20%，同比增长显著。目前，1200V 40mohm SiC MOSFET 芯片研制成功并通过可靠性验证；车规 1200V 13mohm SiC MOSFET 芯片可提供特性样品；自研 SiC SBD 芯片通过终端客户验证，实现批量出货。模块产品方面，车规级 1200V SiC 自研模块正在研制中，对应的银烧结工艺已通过可靠性验证，为下一步车规模块产品的开发提供了坚实的技术平台。此外，公司具备双面散热、高功率密度等关键封装能力，为 SiC 器件落地应用奠定技术平台。 本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。 4、公司在光伏储能市场领域有什么布局？ 公司在光伏储能市场持续深化产品布局与技术研发，目前储能用 650V 三电平产品已实现批量交付，能够满足新能源发电与储能市场对高效、稳定功率模块的需求。公司正重点布局高压及特高压等高端应用

	场景，通过技术创新提升产品附加值，进一步强化在光伏储能产业链中的竞争力。 本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。 5、近期关税政策否对公司出口业务有影响？海外拓展情况如何？ 目前公司收入仍以国内市场为主，海外业务占比较小，近期关税政策变化对公司整体影响有限。公司正在积极拓展海外市场，有关产品已成功进入某些国际客户供应体系，验证了公司产品的国际化适配能力。后续将继续推进海外认证与项目合作，重点聚焦新能源与工业场景，提升全球市场的渗透率。 本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。 6、公司在数据中心领域的产品布局与市场拓展策略 数据中心、服务器电源、机器人等新兴应用领域是公司今年重点开拓的新增长点。随着 AI 的发展，数据中心对服务器和 UPS 的需求也在快速增长，公司正在加速推动 AI 服务器订单，目前已与多家国际客户建立了长期稳定合作关系，可为客户提供定制化与标准化产品，持续加码新兴领域的市场渗透。 本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。 7、公司和上游厂商建立了战略合作关系，合作模式是什么？ 公司与上游优质供应商——华虹宏力建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，双方在 IGBT 与 FRD 等核心产品，围绕技术创新、平台开发、加速量产、市场拓展等多个维度展开深度合作，致力于提升整体竞争力。这一举措能够有效保障供应链稳定，保证原材料供应的稳定性与质量可靠性，有效降低了因原材料价格波动和供应短缺对生产造成的影响，确保公司能够按时、高质量地向市场提供产品。 本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。 8、公司有没有考虑选择合适的标的并购重组？ 公司一直注重上下游及业务协同整合，围绕公司发展战略考虑投资机会，持续关注市场环境和政策导向，寻求与具有技术领先及有独特工艺能力的创新企业开展业务合作，在时机成熟的情况下会考虑并购重组，扩大公司的业务版图，推动公司实现高质量发展。公司后续如有相
--	--

	关计划，将严格按照相关法律法规及时发布公告。 本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。 9、公司 2025 年发展战略如何规划？ 首先，在产品端，2025 年将加速 SiC/GaN 等第三代半导体产业化进程与高压大电流产品（3300V 以上）升级，公司控股子公司——上海宏微爱赛半导体有限公司作为第三代半导体产品研发中心，是公司布局新兴技术领域的重要平台，未来将聚焦高压大电流产品方向。其次，在下游市场方面，巩固光伏、汽车及工控头部客户，拓展高压平台客户，提升高毛利产品占比，同时积极布局机器人、数据中心等新兴领域；再次，在内部管理方面，通过自研芯片比例提升，封测产能稳步扩建及降本增效，推动毛利率持续提升。未来将继续聚焦功率半导体主航道，致力于成为客户信赖投资者认可的功率半导体先进企业。 本回复不构成任何投资建议，具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。
说明	1、接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。前来公司现场调研的投资者均已签署《调研承诺书》。 2、本记录表未列出部分与前期投资者活动重复的问题和回复，详情可查阅公司前期披露的投资者关系活动记录表。 3、本次活动不涉及应当披露重大信息，不构成任何投资建议，本记录表涉及的具体信息请以公司披露的临时公告与定期报告为准。